

**IEC 62047-10**  
(First edition – 2011)

Semiconductor devices –  
Micro-electromechanical devices –

Part 10: Micro-pillar compression test for MEMS  
materials

**CEI 62047-10**  
(Première édition – 2011)

Dispositifs à semiconducteur –  
Dispositifs microélectromécaniques –

Partie 10: Essai de compression utilisant  
la technique des micro-piliers pour les  
matériaux des MEMS

## **CORRIGENDUM 1**

### **5.3 Test procedure**

*Replace, in item e) of this subclause, “If necessary repeat b) and d)” by “If necessary, repeat b) to d)”.*

### **5.3 Procédure d’essai**

*Remplacer, au point e) de ce paragraphe, “Si nécessaire, répéter b) et d)” par “Si nécessaire, répéter b) jusqu’à d)”.*